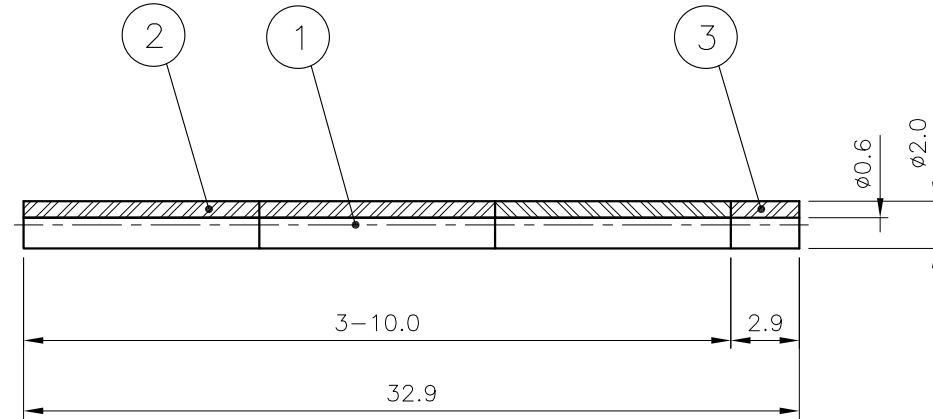


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.H.KIM		2024.01.04.



* 조립 후 검사 주의사항

1. PIN과 절연체 조립 후 PIN 양끝단이 절연체 보다 돌출되지 않도록 주의 할 것.
2. PIN+절연체 조립시 헐겁지 않게 관리 필요.
(발주 진행 시 PIN 한도 견본을 절연체 외주 가공업체에 전달하여
조립 후 길이나 절연체가 헐겁지 않게 관리 될 수 있도록 내용 전달 필요.)

3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02926-N/2
2	INSULATOR	3	TEFLON		DIN02923-N/1
1	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT03869-5/2
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal ±0.1	DATE 2024. 01. 04.			 COMTECH KJ COMTECH CO.,LTD.	RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
	Angle ±1°	APPROVED BY						
MATERIAL _____	CHECKED BY			TITLE BUSHING				
	DRAWN BY S.H.KIM							
FINISH _____	SCALE 3/1	UNIT mm		A4	DWG NO. CN03722-7/2			
	REVISION I R				SHEET 1 of 1			



A4